

## 100-2 大葉大學 完整版課綱

### 基本資訊

課程名稱	電子封裝概論	科目序號 / 代號	0598 / MAI4024
開課系所	機械與自動化工程學系	學制 / 班級	大學日間部4年4班
任課教師	鄭江河	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(二)56 / H440 (三)9 / H440	授課語言別	中文

### 課程簡介

電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。









### 課程大綱

- 1 前言
- 2 聯線技術
- 3 塑膠構裝
- 4 陶瓷構裝
- 5 薄/厚膜技術
- 6 捲帶自動接合
- 7 覆晶接合
- 8 異方性導電膠
- 9 新型構裝技術

### 基本能力或先修課程

半導體製程、微機電系統概論

### 課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  運用數學、科學及工程知識的能力
-  設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力
-  執行工程實務所需技術、技巧及使用工具之能力
-  設計工程系統、元件或製程之能力
-  計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力
-  發掘、分析及處理問題的能力
-  認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力
-  理解專業倫理及社會責任

## 教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
運用數學、科學及工程知識的能力	20%	學生能夠以微積分基本原理推導機械工程相關方程式。 2. 學生能整合力學、電學、機械專業知識於機電整合應用例中。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	20
設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力	20%	能安排及進行實驗操作。 能夠利用儀器量取所需數據、並能排除實驗障礙。 能夠以圖示或表格整理數據，並解釋數據的變化傾向。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	20
執行工程實務所需技術、技巧及使用工具之能力	15%	學生能操作加工機具，製作簡單之零件。 學生能操作電腦製作電腦程式。 學生能操作電腦輔助繪圖工具進行機械或電路繪圖。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	15
設計工程系統、元件或製程之能力	15%	學生能運用電腦輔助工程軟體設計機械或機電零件。 學生能設計機器、車輛、自動化製程系統的元件。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	15
計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力	5%	學生能自我管理計畫進度。 具有與同學溝通的能力。 學生具有協調工作的能力。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	5

發掘、分析及處理問題的能力	5%	能發現工程設計錯誤或評估設計需求。 能尋找解決工程設計錯誤或達成設計需求的方法。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	5
認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力	15%	學生了解專業科目在科技議題所佔的角色。 學生知道工業時事及技術的資訊來源可從報紙、網路、及教科書尋找。 學生能養成平日與長久持續學習的習慣。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	15
理解專業倫理及社會責任	5%	學生了解專業軟體具有智慧財產權。 學生了解更換工作企業所應有的保密要求。 學生了解企業對社會的環保責任。	講述法 個案討論 影片欣賞	小考: 10% 期中考: 20% 期末考: 20% 課程參與度: 20% 書面報告: 20% 上課筆記: 10%	加總: 100	5

### 成績稽核

期中考: 20%  
 期末考: 20%  
 書面報告: 20%  
 課程參與度: 20%  
 小考: 10%  
 上課筆記: 10%

### 教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
自編講義	鄭江河			0

### 參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

無參考教材及專業期刊導讀

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	前言	100				
2	聯線技術	100				
3	塑膠構裝	100				
4	塑膠構裝	100				
5	陶瓷構裝	100				
6	陶瓷構裝	100				
7	薄/厚膜技術	100				
8	期中考	0				100
9	薄/厚膜技術	100				
10	捲帶自動接合	100				
11	捲帶自動接合	100				
12	覆晶接合	100				
13	覆晶接合	100				
14	異方性導電膠	100				
15	異方性導電膠	100				
16	新型構裝技術	100				
17	新型構裝技術	100				
18	期末考	0				100